

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006 年 9 月 14 日 (14.09.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/095643 A1(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) B24B 37/00 (2006.01)CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1960021 東京都昭島市武蔵野
3 丁目 4 番 1 号 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/304050

(72) 発明者; および

(22) 国際出願日: 2006 年 3 月 3 日 (03.03.2006)

(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 小林 俊裕

(25) 国際出願の言語: 日本語

(KOBAYASHI, Toshihiro) [JP/JP]; 〒1960021 東京都

(26) 国際公開の言語: 日本語

昭島市武蔵野 3 丁目 4 番 1 号 日本マイクロコーティン

(30) 優先権データ:
特願2005-061735 2005 年 3 月 7 日 (07.03.2005) JP

グ株式会社内 Tokyo (JP). 泉 敏裕 (IZUMI, Toshihiro)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本ミク
ロコーティング株式会社 (NIHON MICROCOATING

[JP/JP]; 〒1960021 東京都昭島市武蔵野 3 丁目 4 番

1 号 日本マイクロコーティング株式会社内 Tokyo (JP).

田村 淳 (TAMURA, Jun) [JP/JP]; 〒1960021 東京都昭

島市武蔵野 3 丁目 4 番 1 号 日本マイクロコーティン

グ株式会社内 Tokyo (JP). 永峯 拓也 (NAGAMINE,

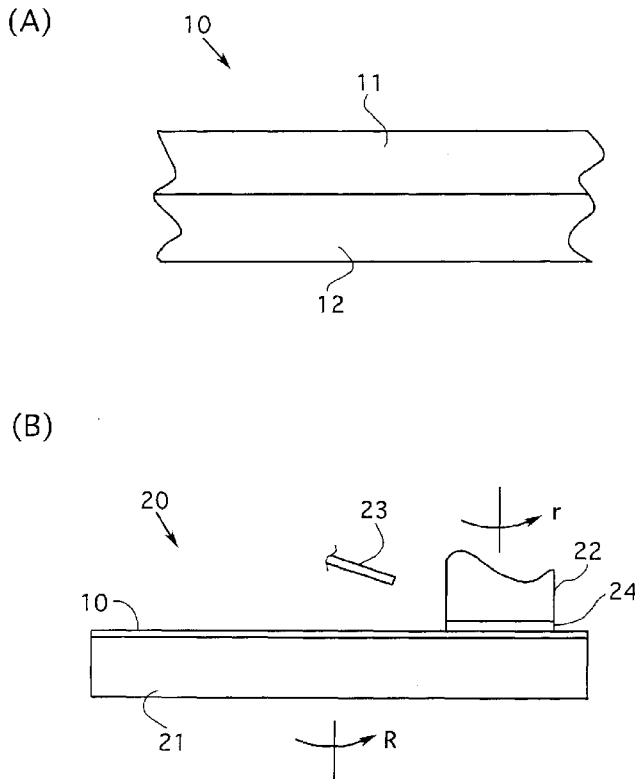
Takuya) [JP/JP]; 〒1960021 東京都昭島市武蔵野 3 丁

目 4 番 1 号 日本マイクロコーティング株式会社内

/ 続葉有 /

(54) Title: POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド



(57) Abstract: A polishing pad is provided for uniformly planarizing a wafer surface in a short time. The polishing pad (10) is composed of a pad main body (11) having a polishing surface and a lining (12) fixed on a rear surface of the pad main body (11). The elastic modulus of the pad main body (11) is within a range of 600psi-16,000psi, preferably 1,600psi-16,000psi, when a compression pressure of 2psi to 16psi is applied. The thickness of the pad main body (11) is within a range of 0.5mm-3.0mm. The elastic modulus of the lining (12) is within a range lower than the elastic modulus of the pad main body (11) but higher than 300psi, when the above mentioned compression pressure is applied.

(57) 要約: ウエハの表面を短時間で均一に平坦化できる研磨パッドを提供することである。研磨面を有するパッド本体 11 と、パッド本体 11 の裏面に固定した裏当て 12 とから構成される研磨パッド 10。パッド本体 11 の弾性率は、2 psi から 16 psi の圧縮圧力をかけたときに、600 psi ~ 16000 psi の間の範囲にあり、望ましくは 1600 psi ~

16000 psi の間の範囲にある。パッド本体 11 の厚さは、0.5 mm ~ 3.0 mm の間の範囲ある。裏当て 12 の弾性率は、上記の圧縮圧力をかけたときに、パッド本体 11 の弾性率よりも低く且つ 300 psi を超える範囲にある。

WO 2006/095643 A1



Tokyo (JP). 荒幡 高志 (ARAHATA, Takashi) [JP/JP]; 〒1960021 東京都昭島市武蔵野 3 丁目 4 番 1 号 日本ミクロコーティング株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 竹内 澄夫, 外 (TAKEUCHI, Sumio et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋 1 丁目 6 番 2 1 号 NBF 虎ノ門ビルディング Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 *PCT* ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。